

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-227768

(43) 公開日 平成8年(1996)9月3日

(51) Int.Cl.  
H 01 R 33/76識別記号  
7354-5BF I  
H 01 R 33/76

技術表示箇所

検査請求 未請求 消求項の数1 FD (全3頁)

(21) 出願番号	特願平7-56555
(22) 出願日	平成7年(1995)2月21日

(71) 出願人 000102500  
エスエムケイ株式会社  
東京都品川区戸越6丁目5番5号

(72) 発明者 吉田 光太  
東京都品川区戸越6丁目3番5号 エスエムケイ株式会社内

(72) 発明者 久田 浩司  
東京都品川区戸越6丁目6番5号 エスエムケイ株式会社内

(74) 代理人 弁理士 田中 雅雄

## (34) 【発明の名称】 ICパッケージ用ソケット

## (57) 【要約】

【目的】 装着されるICパッケージの浮き上がりを防止する。

【構成】 Jペント型のリード102を有するICパッケージが装着される装着空間12が内側に形成された格子のインシュレーター11と、該インシュレーター11上に配置され、前記リード102に当接する接觸部17及び弹性変形して前記接觸部17を前記装着空間12側へ押圧する屈曲部16が形成されたコンタクト15を有するICパッケージ用ソケットにおいて、前記コンタクト15の前記接觸部17に対して開口側の配置に、前記装着空間12側へ突出する凸部19を、前記ICパッケージの装着時において前記接觸部17を底側へ向ける形で形成する。

